JDB920N 导热硅凝胶

产品描述

JDB920N是一种流动性好，具有可自修复性能的加成型双组分有机硅导热填缝材料。固化后形成柔软的导热硅凝胶，优异的电性能使其非常适合应用于各种高纯度要求的电子元器件密封，具有为电子元器件提供缓冲、减震和散热等功能的特点。

产品特性

- 双组分 1: 1 （体积比）混合比例，适当的常温操作时间。
- 可室温固化，也可加热快速固化，固化时不释放小分子。
- 模量低，内应力小，抗冷热冲击能力强。
- 优良的粘接性，自修复性，200℃下优良的高温稳定性。

主要性能

项目	典型值		测试标准	
混合前物性(23±2℃/50±5%RH)				
组分	--	A	B	--
外观	--	蓝色半流淌	白色半流淌	--
粘度	Pa•s	250±50	250±50	GB/T 15223-2008
比重	g/cm ³	2.0±0.10	2.0±0.10	GB/T 13477.2-2002
混合后物性(23±2℃/50±5%RH)				
重量比混合	--	A:B=1:1		GB/T 13477.2-2002
外观	--	蓝色		---
粘度	Pa•s	250±50		GB/T 15223-2008
可操作时间(25℃)	min	60~70		--
完全固化时间(25℃)	h	4~8		
完全固化时间(100℃)	min	10~25		GB/T 13477.5-2002
固化后性能(23±2℃/50±5%RH×24hours)				
硬度	Shore oo	50±5		GB/T 531.1—2008
导热系数	W/m•K	2.0±0.2		GB/T 10297-1998
介电强度	kV/mm	≤15		GB/T 1408.1—2006
介电常数(60HZ)	--	≤4.0		GB/T 1409—2006

体积电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	$\geq 1.0 \times 10^{12}$	GB/T 1410—2006
介电损耗 (60HZ)	--	0.02	GB/T 1409—2006
阻燃等级	UL94	V-0	ASTM
工作温度	$^{\circ}\text{C}$	-50~200	--

使用说明

- 将被施胶物体的表面清理干净，并保持洁净表面干燥。
- 产品室温下快速固化，24小时完全固化。

注意事项

- 使用前，请详细查阅MSDS。
- 胶料应密封贮存，混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。
- 本品属非危险品，但避免接触皮肤及眼睛。
- 长时间存放后，胶中的填料会有所沉降。请搅拌均匀后使用，不影响性能。
- 胶液接触一定量的以下化学物质会导致胶不固化：
  - 1、含N、P和S等的有机化合物。
  - 2、含Sn、Pb、Hg和As等元素的离子性化合物。
  - 3、含炔烃及多乙烯基的化合物。
- 为了避免上述现象，胶液灌封使用前，应尽量擦干净器件上面残留的松香，尽量使用低铅含量的焊锡。

包装规格

- 50cc、200cc、400cc 双管点胶管、桶装。

储存及运输

- 远离儿童存放，保持产品避光和避热，并且密封保存。
- 在 28 $^{\circ}\text{C}$ 或低于该温度未开封保存时，产品自生产之日起保质期为 6 个月。
- 本产品为非危险品，按一般化学品贮存、运输。

我们能为您提供哪些帮助？

请告知我们您的性能、设计和制造问题。我们将利用我们的硅基物料专知，敷涂知识和加工经验为您提供服务。